

RÉSINE 613

NOUVEAU

Résine d'enrobage durcissant à température ambiante, basse viscosité et sans CMR*.

L'enrobage est une étape de la préparation des échantillons métallographiques qui permet de pré-polir et de polir des pièces de façon plus ergonomique. Dans certains cas une imprégnation peut être nécessaire pour préserver l'intégrité de l'échantillon.

Description

La résine 613 est une résine époxydique dure, bi-composant utilisée pour réaliser des enrobages métallographiques techniques de haute qualité à température ambiante.

La résine 613 a un retrait très faible, une excellente adhérence à toutes sortes de matériaux et une très bonne résistance chimique.

Avec une viscosité idéalement ajustée, la résine 613 sert à enrober des échantillons métallographiques ayant des formes complexes, des porosités ou des revêtements techniques délicats.

Cette résine est le meilleur choix quand la transparence et/ou la dureté de l'enrobage sont des exigences.

Caractéristiques

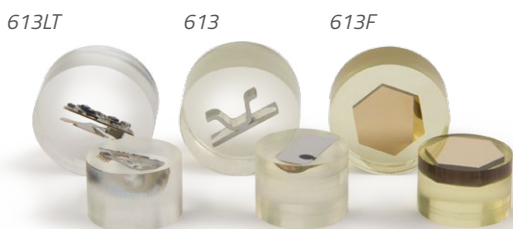
Température de polymérisation limitée.

Peut être utilisée en imprégnation avec l'appareil d'enrobage sous vide M.M.818.

Le débullage et le retrait peuvent également être améliorés avec l'utilisation de l'appareil d'enrobage sous pression M.M.808.

Ne contient pas de CMR.

Mise en œuvre facile, 2 composants.



Disponible également en version à durcissement rapide 613F et à durcissement sans élévation de température 613LT.



Échantillons enrobés après polissage



Fiche technique	RÉSINE 613
Matériau	Époxy
Conditionnement	Kit Résine liquide 1000 ml + Durcisseur 500 ml Code KIT0600613 00 Résine liquide 1000 ml - Code 06 02613 00 Durcisseur 500 ml - Code 06 01613 00
Dosage	2 volumes de résine pour 1 volume de durcisseur
Aspect	Transparente et incolore
Temps de polymérisation	10 h à 20 °C
Dureté	85 Shore D
Température exothermique	50 °C**
Retrait volumétrique	très faible, 0 µm si utilisée avec l'appareil M.M.808
Présence de CMR*	non
Utilisable en imprégnation	oui



* CMR : Cancérogène, Mutagène, Reprotoxique.

** Température exothermique de pointe pendant la polymérisation pour un échantillon de 40 g de résine à 20 °C.



Fiche de données de sécurité